



Desktop-Systeme für Reflow-Löten

Die Desktop-Serie bietet die gleiche hohe Bondqualität wie die größeren und automatisierten Systeme. Sie besitzt zudem ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis (Durchsatz). Der Schlitten ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen der Teile direkt vor dem Bediener. Wenn die Teile ausgerichtet werden müssen, kann dies in der vorderen Position (Ladeposition) erfolgen, wo der Bediener genügend freien Platz zum Laden und Ausrichten der Teile hat. Die Position der Kamera bietet eine Sicht, die nicht durch den Bondkopf blockiert wird. Der automatische Schlitten verbessert die Kontrolle beim Positionieren von Teilen im Vergleich zu manuell bedienbaren Schlitten. Außerdem kann der Bediener Zeit für andere Aktionen aufwenden, wie das Vorbereiten der nächsten Teile zwischen den Bondzyklen.

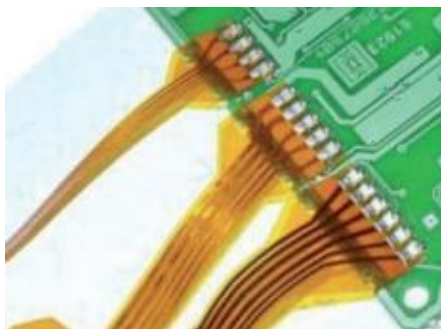
Key Features Reflow Soldering Desktop Systems

- Small and flexible systems for high quality connections
- Ideal price-performance (throughput) ratio
- Simple adjustable frame construction
- For Heat-Seal bonding, Hot Bar Reflow Soldering and Heat Staking
- Reliable process control, by proven technology of Uniflow Power Supply

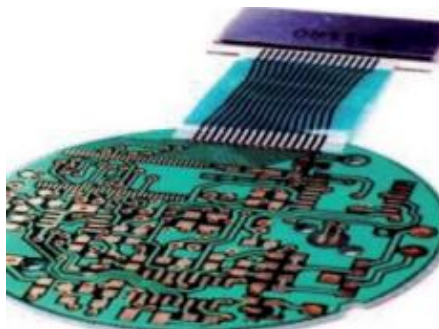
Specifications Desktop-Systeme für Reflow-Löten

Modell			
Leistungsanforderungen	100 to 240 Vac, 50/60 HZ, 16 Amp max		
Air supply	4-8 bar (60-120 psi), dry & filtered air		
Maximum fixture height	50 mm (1.97 inch)		
Gantry open width	520 mm (20.47 inch)		
Fixture assembly baseplate	160 x 160 mm (6.30 x 6.30 inch)		
Inbetriebnahme	Two hand control		
Betriebstemperatur	15 - 40 °C		
Betriebsfeuchtigkeit	93% @ 40 °C		
Bonding head & uniflow technical specifications			
Kraftbereich	SH 500:50 - 500 N @ 6 Bar - SH 80:8 - 80 N @ 6 bar		
Hot Bar stroke	SH 500: 50.0 mm - SH 80 : 50.0 mm		
Temperaturbereich Leerlauf	25 to 100 °C	Heat	60 to 600 °C
Temperaturbereich Grundwärme	25 to 300 °C	Heat Extended Range	60 to 999 °C
Temperaturbereich Vorheizen	60 to 300 °C	Postheat	25 to 600 °C
Zeitperiode (in Schritten von 0,1 s) Grundwärme	0 to 99.9 seconds	Rise to Heat Time	0 to 9.9 seconds
Zeitperiode (in Schritten von 0,1 s) Anstieg zur Vorheizzeit	0 to 9.9 seconds	Heat	0.1 to 99.9 seconds
Time period (in 0.1 Sec increments) preheat	0 to 99.9 seconds or continuous	Postheat	0 to 99.9 seconds
Kommunikationsanschlüsse	RS-232, RS-485		
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	510 x 550 x 600		
Gewicht (in kg)	40 kg (excluding Uniflow Power Supply)		

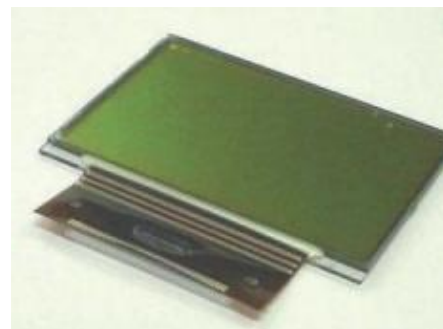
Product applications Desktop-Systeme für Reflow-Löten



Hot Bar reflow soldering



Heat-seal bonding



ACF bonding



Heat staking

AMADA[®]

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES



AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
info@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu
ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



follow us on:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU